News Release

公司联系方式:

Uma Subramaniam Sr. Marcom Manager, Corporate Communications (408) 875-5473 uma.subramaniam@kla-tencor.com

代理公司联系方式: David Moreno

Account Manager, MCA (650) 968-8900 x125 dmoreno@mcapr.com

KLA-TENCOR 在中国扩展新机构

KLA-Tencor 高层参加 SEMICON China 2002 共商未来业务扩展大计

中国上海,2002年3月26日讯— KLA-Tencor公司 (Nasdaq: KLAC) 高层将参加今年在上海举行的 SEMICON中国展(3月26-27日),共商公司在该地区的最新发展状况与未来扩展大计。作为在过去几年内积极参与中国发展的一员,KLA-Tencor公司计划扩展在中国的机构,建立一个全球支持中心,作为除日本外的整个亚太地区的应用与服务中心。

新中心的成立将使 KLA-Tencor 公司能与该地区客户更密切地合作,包括宏力半导体制造有限公司 (GSMC) 与中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 (SMIC),这两家公司都已大量订购 KLA-Tencor 的工艺控制设备系列产品。这些设备的引入,使 GSMC 与 SMIC 拥有了以更低成本提高产出率以及优化设备性能所需的新技术,从而能够满足该地区更强劲的需求。随着全球的工业向更小的芯片与新的半导体工艺转变,例如铜工艺,KLA-Tencor 必将扮演重要的角色,帮助其中国客户做好利用这些新技术投入批量生产的准备。

最近几个月,KLA-Tencor 已经推出了一系列工具与服务项目,旨在帮助芯片制造商增强对设备产出率的控制能力,其中包括 µLoop 和 iMove。µLoop 是一种具有革命意义的技术,可使芯片制造时的每个电气产能实现周期从八周缩短到几天,而 iMove 服务项目旨在提供高性价比、灵活的工厂搬迁支持,以适应亚洲半导体工业的迅速发展,从而保护厂商对这些工具的投资。随着 200mm 晶片制造技术从亚洲其它国家迅速引入中国,这项服务对于中国扩展其半导体市场的举措,尤其具有重要的意义。

KLA-TENCOR 宣布在中国的发展战略·······2/2 页

KLA-Tencor 公司中国区总裁李家震先生将参加"国际半导体设备与材料 (SEMI) 制造技术与材料研讨会",并于 3 月 26 日 13:30 在上海世贸商城 2 层 5A 室会议发表演讲,介绍先进的晶片制造工艺的新型产出管理技术。李先生在 SEMICON China 2001 上被任命为 KLA-Tencor 公司中国区总裁。

KLA-Tencor 中国公司地址为上海市新金桥路 28 号新金桥大厦 1902 室 (201206)。如需了解更多信息,请与公司联系,电话: +86-21-58342435,传真: +86-21-58346654。

欢迎参加在上海国际会议中心举行的 SEMICON China 2002, 莅临 KLA-Tencor 公司 810 号展位。

KLA-Tencor 公司简介: KLA-Tencor 是全球领先的专为半导体制造和相关行业提供过程控制和产出管理解决方案供应商。公司总部设在美国加利福尼亚州圣何塞,在世界各地设有办事处和服务机构。作为 S&P500 强企业,KLA-Tencor 公司在 Nasdaq 上市交易,交易代码 KLAC。欲了解更多信息,请访问公司网站http://www.kla-tencor.com

###